

2021年2月25日

各位

会社名 宇部エクシモ株式会社
本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町9番19号
問合せ先 経営管理本部長 多田 厚美
TEL 03-6667-2411

「ユピセル®N」微細配線用CCLのラインナップ拡充について

宇部エクシモ株式会社(社長:高橋俊充)は、無接着剤タイプの銅張積層板(CCL)「ユピセル®N」の微細配線向け極薄銅箔タイプのラインナップを拡充し、売上の拡大を目指す。

ユピセルNは、絶縁層にポリイミドフィルム(PI)を使用した無接着剤タイプのフレキシブル銅張積層板で、携帯端末等のフレキシブルプリント基板の材料として広く採用されている。

近年、スマートフォンなどでは、5Gによる情報通信の高速大容量化やディスプレイ画面の大型化に対応するバッテリーの大容量化により、搭載されるメイン基板を少面積化するために更なる微細配線化が求められている。そのような背景から、プリント基板の回路形成方法も、従来の銅箔層をエッチングして配線を形成する「サブトラクティブ法」に代わる方法として、極薄銅箔CCLの上にめっきで配線を形成する「MSAP(Modified Semi Additive Process)」法が回路微細化の切り札として最有力視され始めている。

ユピセルNでは、金属ベルトを用いて均一に圧力をかける独自のラミネート技術により、銅箔と絶縁材料との密着性が高く、かつキャリア銅箔が剥離しやすい極薄銅箔CCLを実現した。銅箔に三井金属鉱業(株)のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」を用い、現在銅箔厚み1.5μmまでの対応が可能である。

既に顧客に題するサンプルの提供を開始しており、回路ピッチ40μm以下の配線基板を実現できたとの評価を得ている。今後はサンプルワークを進め、MSAP需要を取り込み、売り上げ拡大を図る。



絶縁層にPIフィルムを使用した
「ユピセル®N」